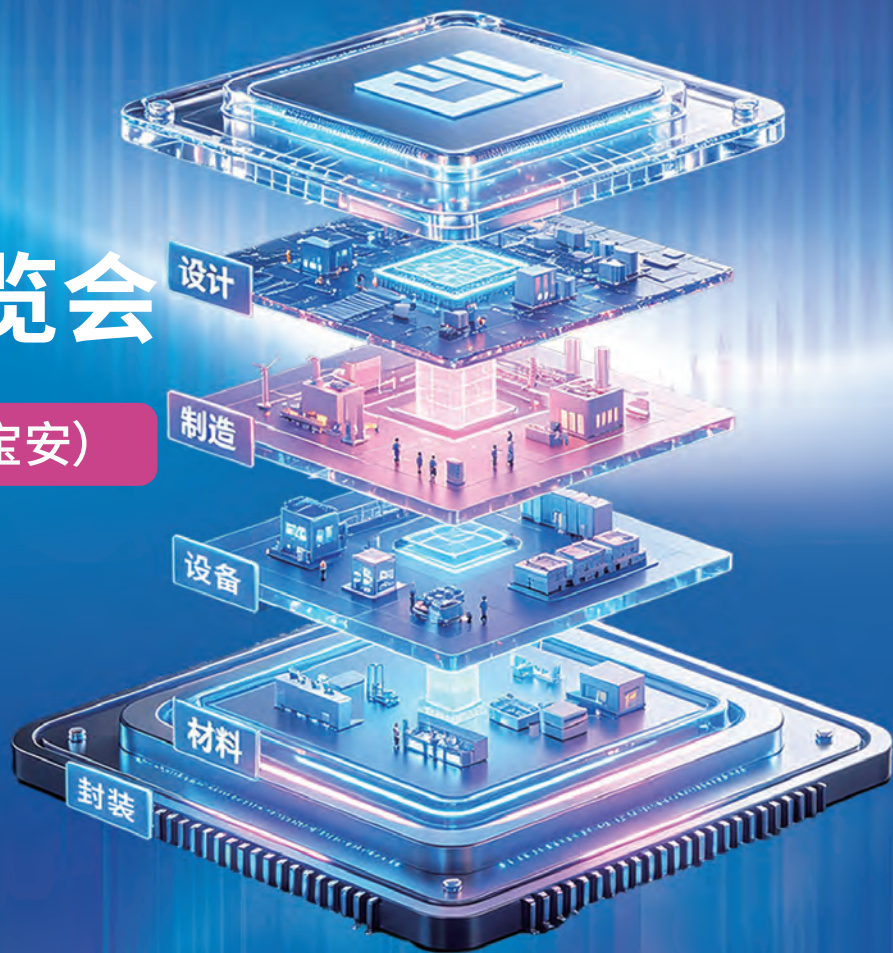


2026 IICIE 国际集成电路创新博览会

2026年9月9-11日 | 深圳国际会展中心(宝安)

展后报告



展后回顾

50,000M²

展示面积

86,452

专业观众

97%

同比去年观众
数量整体增长

935 参展
企业

2,585 海外
观众

243 参观
团

24 同期论坛
及活动



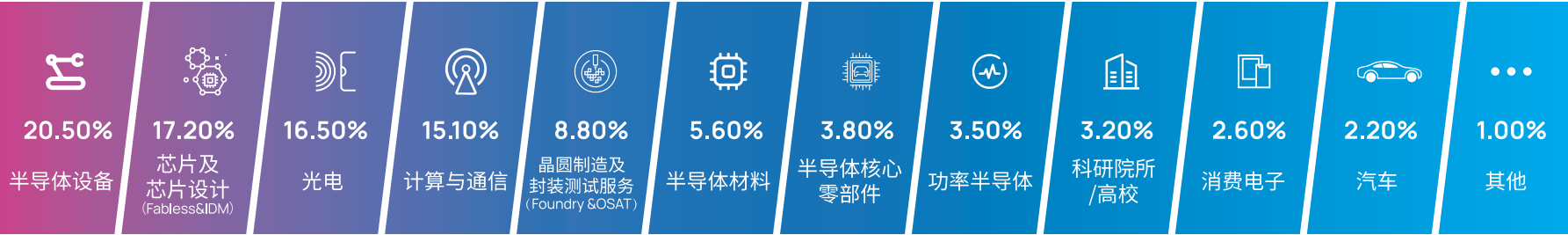
IICIE国际集成电路创新博览会于2026年9月11日在深圳国际会展中心(宝安)圆满收官。

本届展会以“跨界融合·全链协同，共筑特色芯生态”为主题，着力构建具备规模效应的集成电路全产业链高端展示平台，促进行业协同创新与商贸交流合作。展会完整覆盖芯片、晶圆制造及封装测试服务、半导体核心设备、关键材料及核心零部件全产业链生态；共集结优质参展商935家，累计接待专业观众86,452人，其中海外观众2,585人，整体观众数量同比增长97%。

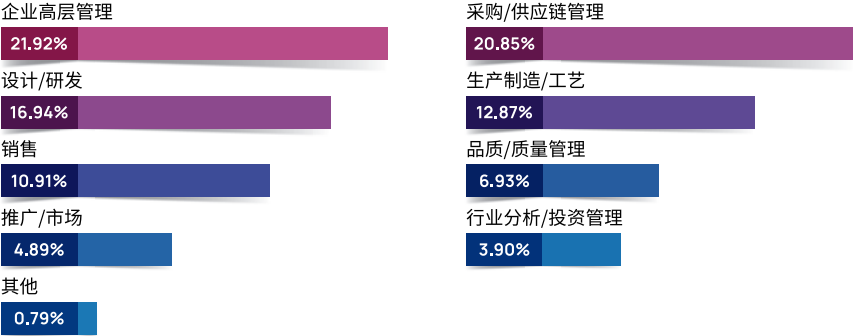
本次IICIE与中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)、elecon深圳国际电子展暨嵌入式展三展联动，展期三天专业观众共计325,810人。

展会同期共计举办24场高质量的专题会议及产业活动，汇集全球集成电路、半导体领域专家学者与企业代表等行业菁英，围绕产业发展趋势、关键技术攻坚等核心议题开展深度研讨。各方通过充分的技术对接与思想碰撞凝聚产业共识，共绘半导体产业高质量发展蓝图，为行业技术创新迭代、产业动能持续释放筑牢坚实基础。

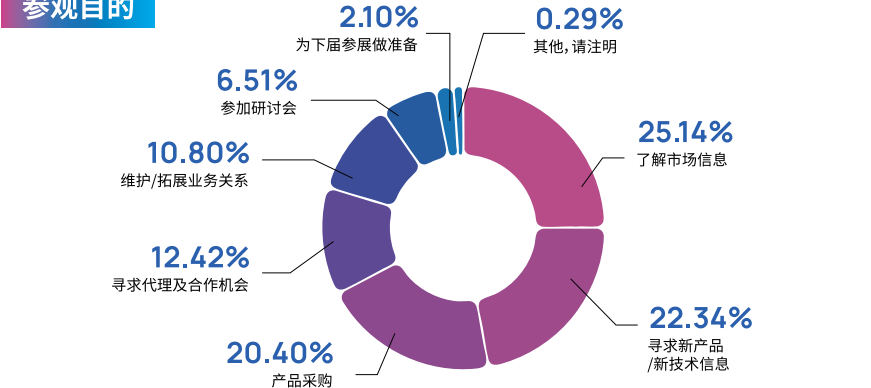
观众概览



职位分析



参观目的



海外观众部分来源国家



01

半导体设备

ASMP-T、DISCO、Applied Materials、北方华创、中微公司、上海微电子、新凯来、盛美半导体、纳设智能、新益昌、精测电子、芯上微装、大族富创得、长川科技、海海清科、矽电半导体、天准科技；

03

光电

长芯博创、中际旭创、光迅科技、优迅股份、长光华芯、仕佳光子、源杰科技、铨奥光电、通快、老鹰半导体、新易盛、Coherent高意、舜宇光学、凤凰光学、宇瞳光学、联合光电、辰瑞光学、联创电子、福特科光电；

05

晶圆制造及封装测试服务 (Foundry & OSAT)

GlobalFoundries、华虹半导体、中芯国际、三星半导体、积塔半导体、Tower Semiconductor、晶合集成、新芯股份、粤芯、增芯、芯联集成、润鹏半导体、鹏芯微、鹏新旭、燕东微电子、通富微电、盛合晶微、长电科技、华天科技、天成先进、利扬芯片、气派科技、沛顿科技、风华芯电、华芯微电子；

07

功率半导体

中车时代、安世半导体、上海贝岭、三菱半导体、罗姆、英飞凌、安森美、恩智浦、士兰微、英诺赛科、扬杰科技、基本半导体、深爱半导体、芯粤能、镓未来、国芯微电子；

09

汽车

比亚迪汽车、广汽集团、小鹏汽车、理想汽车、法雷奥、极氪汽车、吉利汽车、长城汽车、龙旗汽车电子、奇瑞汽车、地平线、北汽研究总院、德赛西威、比克汽车、岚图汽车；

02

芯片及芯片设计 (Fabless & IDM)

意法半导体、中兴微电子、华润微电子、江波龙、长江存储、长鑫存储、SK海力士、三星半导体、比亚迪半导体、安世半导体、平头哥半导体、海思半导体、芯海科技、格科微电子、紫光国微、紫光展锐；

04

计算与通信

中国移动、中国电信、华为、锐捷网络、字节跳动、上海诺基亚、北京金山云、中兴通讯、纵横通信、腾讯科技、富士通、海能达、浪潮信息、新华三、研华科技、中科曙光、工业富联；

06

半导体材料

中国有研、住友电工、沪硅产业、江丰电子、上海新阳、天科合达、华特气体、晶瑞电子材料、安集微电子、路维光电、南砂晶圆、英诺赛科、兴森科技、深南电路、天域半导体、欧莱新材、广钢气体；

08

消费电子

科大讯飞、华为终端、Apple、OPPO、VIVO、Amazon、Lenovo、Sony、大疆创新、小天才、小米科技、传音控股、华勤技术；

10

科研院所

中国科学院微电子研究所、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、广东省科学院半导体研究所、中科院深圳先进技术研究院、广州大湾区集成电路与系统应用研究院、广东中科半导体微纳制造技术研究院、珠海先进集成电路研究院、鹏城实验室、之江实验室、平湖实验室、季华实验室、嘉庚创新实验室、人工晶体研究所、松山湖材料实验室；

*以上仅部分代表企业，排名不分先后

展商概览



86.3%

展商愿意向同行及
行业伙伴推荐



84.4%

对2026年展会总体参展效果
表示满意或非常满意



82.2%

表示会继续参展



935

参展
企业

部分参展企业

晶圆制造及封装



半导体设备



半导体材料、化合物半导体



半导体核心零部件



芯片及功率器件



*以上仅部分企业, 排名不分先后

高校及科研院所展示区

参与院所及高校:清华大学(集成电路学院)、上海交大无锡光子芯片研究院、华南师范大学微电子学院、广东中科半导体微纳制造技术研究院、广东省大湾区集成电路与系统应用研究院、广州市香港科大霍英东研究院、中山大学集成电路学院、深圳理工大学、北京理工大学重庆微电子研究院、深圳职业技术大学集成电路学院、深圳技术大学集成电路学院、深圳先进电子材料国际创新研究院、珠海科技学院等。



芯片及应用特色展示区

芯片及芯片设计:智现未来、象帝先、一微科技、澜昆微、智芯科、泰芯半导体、合肥云联、安信达等。

AI特色展示区:灿芯半导体、极海半导体、六岳微电子、京微齐力、康盈半导体、图灵智新、二进制半导体等。

RISC-V 生态应用展示区:达摩院玄铁、清芯智研、中德工业、算能科技、国芯科技、隼瞻科技、进迭时空、芯际无限、砺睿微电子等。



IICIE国际集成电路创新博览会开幕式 暨集成电路创新高峰论坛

开幕式数百位嘉宾齐聚

在本届展会开幕式上,包括:

- **曹健林** IICIE组委会名誉主席、科技部原副部长、季华实验室理事长兼主任;
- **叶甜春** IICIE组委会主席、国家02专项技术总师、中科院微电子所研究员;
- **杜晓黎** 国家01专项技术副总师、联想研究院副院长;
- **朱煜** 国家02专项技术副总师、清华大学教授;
- **张卫** 国家02专项技术副总师、复旦微电子集团董事长、总经理;
- **雷震霖** 集成电路零部件创新联盟理事长;
- **石磊** 通富微电子股份有限公司董事长兼总裁;
- **韦亚一** 中国科学院微电子研究所研究员, SPIE和中国光学学会、会士, 国际先进光刻技术研讨会 (IWAPS) 大会秘书长;
- **陈卫** 广州市半导体协会会长;
- **杨宪承** 中国国际光电博览会创始人、执行主席、深圳市光学光电子行业协会会长;

以及来自集成电路及半导体全产业链各环节的重点企业、高校和科研院所、媒体代表等, 为开幕式注入强劲的行业影响力与专业高度。



集成电路创新高峰论坛

论坛集结行业协会领袖与龙头企业高管带来一线实践分享, 全方位展现了芯片制造领域最新进展与未来方向。



陈卫

广州市半导体协会会长



石磊

通富微电子股份有限公司
董事长、总裁



刘伟平

北京华大九天科技股份有限公司
董事长



陈维良

沐曦股份
创始人
董事长兼总经理



孙鹏

武汉新芯集成电路股份有限公司
总经理



孟樸

高通公司
中国区董事长



陈鲁

深圳中科飞测科技股份有限公司
董事长/总经理



陈杰

紫光国芯微电子股份有限公司
董事长



贾照伟

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
工艺资深副总裁



郭炜

上海东方算芯科技有限公司
副总裁



李炜

上海硅产业集团股份有限公司
常务副总裁



丁成

中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司
副总经理



皮波

深圳市汇顶科技股份有限公司
CTO



俞剑

上海复旦微电子集团股份有限公司
副总经理



陈浩

宁波江丰电子材料股份有限公司
副总裁

*以上嘉宾列名不分先后

特色会议及活动



硅光之夜·高端游轮晚宴

IICIE联合CIOE中国光博会共同举办，本次活动共汇聚超 200 位来自数据中心、光通信、半导体领域的全产业链精英嘉宾，以游轮为主题，打造沉浸式高端社交场景，构建松弛平等的高端社交空间。现场实现上下游深度链接、技术生态共创，高效打通产业资源，助力行业同仁把握市场机遇，携手共启硅光产业全新征程。



IWAPS 第十届国际先进光刻技术研讨会

会议在IICIE同期举办，由中国光学学会主办，中国科学院微电子研究所、中国国际光电博览会、光刻机制造技术创新中心、南京诚芯集成电路技术研究院有限公司和IICIE国际集成电路创新博览会承办，中国科学院大学集成电路学院和中国光学学会光刻技术专业委员会协办，国际光学工程学会 (SPIE) 提供技术支持。

会议由全芯智造、SIEMENS、SMEE、厦门恒坤、赛默飞世尔、KEMPUR、FUJIFILM、东方晶源、PIBOND、ZEISS、Nata、华芯程、上海滴水微光、ADVANTEST、Gigaphoton、KLA、沈阳芯源、费勉科技、Cobetter、Cymer等国内外企业提供支持。

全球半导体分析师大会

本次分析师大会立足2025-2030年全球半导体市场演变脉络，邀请了来自**美国、德国、丹麦、印度、英国、新加坡、日本、中国**等国家和地区的顶级研究机构专家、产业策略师与市场分析师，既聚焦AI驱动的技术范式革新，也关注全球供应链的区域化重构，更深挖新兴市场的战略机遇，为与会者提供兼具前瞻性预判与实操性价值的战略洞见。



同期论坛

同期
论坛
共计

24 场

演讲
嘉宾

300 位

以面对面交流、专业技术探讨为纽带，厘清行业市场前景与技术发展路线，助力参展企业实现高效品牌曝光，为企业战略布局输出关键决策参考。



多场细分主题论坛, 聚焦半导体前沿热点

半导体制造

- AI算力时代硅光产业峰会
- 先进材料创新发展大会—突破互连与散热极限—AI 异质整合封装之关键材料
- 半导体制造核心设备与零部件发展论坛

先进封装

- 第十届中国系统级封装大会SIP
- MicroLED CPO产业链创新发展高峰论坛
- 先进封装与测试技术论坛—从CoWoS到CoPoS：共探AI时代先进封装技术演进与供应链布局

芯片及芯片应用

- RISC-V产业生态创新大会
- 第三届AI赋能消费电子创新论坛
- 第二届边缘AI与智能控制技术行业论坛
- 端侧AI芯势力：2026智能终端芯片生态峰会
- 智算之源：2026芯算力创新峰会
- 汽车芯片产业创新论坛
- 《Chip》芯片设计创新发展论坛
- EDA与IP电子设计论坛

宽禁带半导体

- 宽禁带半导体技术与产业协同会议——SiC/GaN 嵌埋PCB装备及材料供应链专题

智能制造

- 具身智能产业大会——从算力到执行，构建具身智能系统
- 智能工控赋能自动化创新论坛

绿色厂务

- 半导体洁净厂务与能源管理论坛

同期活动：

- FDSOI(全耗尽绝缘体上硅)工艺发展及应用论坛
- 第八届“复微杯”大学生电子设计大赛颁奖
- 示范性微电子学院产学研融合发展联盟理事会暨院长论坛(闭门)

演讲嘉宾代表



甘甫焄

上海赛勒光电子科技有限公司
首席执行官



蒋鹏飞

武汉新芯集成电路股份有限公司
市场总监



严然

广州增芯科技有限公司
全球商务中心副总



李晓其

华海清科股份有限公司
工艺总监



朱剑

上海曦智科技股份有限公司
副总裁



Angeline Tee

Silicon Austria Labs
Strategic Initiatives
& Partnerships Lead



Victor Veliadis

Executive Director & CTO
PowerAmerica



Gary Huang

Corp VP, Head of Asia Pacific
– Research and Business
Development
YOLE Group



刘海涛

华天科技
项目经理



田禾

清华大学集成电路学院
长聘副教授、副所长



冷生辉

北京中电科电子装备
有限公司
副总经理



王鸣昕

江西沃格光电集团
股份有限公司
副总裁兼首席战略官



郭超

青禾晶元半导体科技
(集团) 有限责任公司
联合创始人&副总经理



徐鹏

浙江芯植微电子科技有限公司
管理运营中心总监



史洪宾 博士

上海艾为电子技术
有限公司
芯片封装首席专家



李天鸣

华封科技
销售副总监

*以上仅部分嘉宾, 排名不分先后

非展期的会议及活动 持续触及优质资源

长三角集成电路“先进封装与测试”技术与产业生态大会

2026年5月16日 无锡

大会汇聚450+行业精英，聚焦先进封装技术创新与半导体全产业链生态协同，集结行业龙头，共享前沿技术成果与落地实践经验。

大会设置两大核心专题，精准覆盖行业热点赛道。上午聚焦AI算力赋能先进封装创新，围绕算力芯片集成封装、芯粒测试、HBM产业发展、AI芯片封测等核心议题展开深度研讨。下午聚焦全产业链协同升级，企业代表针对三维集成键合、光电融合封装、2.5D/3D先进封装等前沿技术突破开展交流分享，为集成电路封测行业技术迭代与产业高质量发展赋能。



AI赋能消费电子创新应用论坛

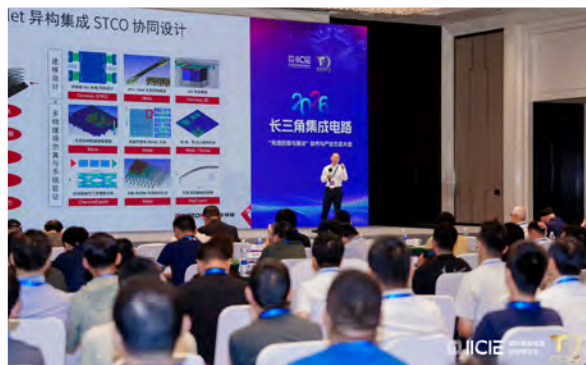
2026年4月10日 深圳

会议累计吸引超300+人参会，汇聚阿里云、三星半导体、佰维存储、康芯威存储、大普技术、风华创智、聚诚天下、微容电子等行业领军企业，围绕“AI时代下消费电子与存储芯片的产业新机与突围之道”展开深度研讨。



线下沙龙活动

- 2026工控芯片前沿技术沙龙暨企业参访
- AI芯动力，赋能AR/VR新视界
- 半导体封装设备赋能产业升级
- 先进封装异构集成发展对接会



线上直播

- 精密控制在自动化行业应用
- 国产芯存赋能工控智能化与ARM智能终端创新
- 智能感知与机器视觉在自动化的应用

全渠道线上线下整合推广，赋能参展企业品牌增值

全方位线上营销

展会整合官方网站、小程序、社交平台、电子快讯等多元线上渠道，精准定向营销，高效触达行业目标受众，为参展企业持续引流曝光。

邮件发送量

11,004,961+

展会网站访问量

402,479 +

小程序累计用户

210,000+

精细化分类行业资料 匹配产业链需求

依托三展联动产业资源，对行业资料进行梳理归类，涵盖半导体核心零部件、半导体材料产品合集、晶圆制造、封测服务、半导体设备等品类产品手册，助力企业精准对接上下游采购与合作需求。

线上人才招聘专区 打通供需快车道

特别打造线上“人才招聘专区”，助力参展企业精准锁定、高效招揽半导体人才，为半导体企业与行业精英人才搭建高效对接桥梁，加速实现人才供需双向匹配。



新闻报道



集微网



芯查查



中国工控网



集邦化合物半导体



芯榜



半导体产业纵横



750+

152,000+

与集微网、半导体产业纵横、芯榜、中国工控网、集邦化合物半导体、芯查查、中国粉体网等行业媒体合作展会期间对企业进行现场采访，打造多维度营销矩阵；同时与全球150+行业媒体、协会强强联手加大对展会的曝光；

直播采访：洞见AI芯时代

9月10日，华强电子网与IICIE联合在展会同期举办，来自微容科技、算力科技、瑞萨电子、极海半导体、二进制半导体、上海贝岭、SiPhi Inc、先导国贸的8位嘉宾，把AI芯片这条产业链，从云端算力一路聊到车轮之上，直播观看超6.4万人次！



三展联动，通览半导体-光电-电子全产业链

本届展会与CIOE中国光博会、elexcon深圳国际电子展暨嵌入式展同期举办

规模达到

320,000 m²

汇聚参展企业

5,285 家

三天共计吸引观众

325,810 人

展会里程碑式的“三展联动”，并非简单的展会形式合并，而是产业发展内在逻辑的外在显现。面向AI算力集群、先进封装、异构集成等全新应用场景，三展联动释放强大产业集群效应，串联起从芯片设计、晶圆制造、封装测试，到设备材料、核心零部件，再到光电与嵌入式应用的完整半导体产业链。

三展联动 | 精细化主题，相互补位

赋能硅光、CPO、NPO制造及封装

光模块厂商需要深入理解硅光工艺，芯片厂商也开始布局光电集成。加之AI大模型、超算等产业的强劲驱动，光电产业在先进半导体工艺的加持下，技术迭代速度不断加快。单一展馆很难完整覆盖这条完整产业链，而IICIE、CIOE、elexcon 三展联动，恰好补齐算力全链条各个关键环节。

IICIE聚焦半导体制造与先进封装，为硅光、CPO等下一代算力互联技术筑牢产业根基，成熟的晶圆代工产线正推动硅光技术实现规模化量产；

先进封装重点展示CPO、NPO近封装光学、异构集成、HBM高带宽内存等技术落地方案；

集中展现半导体设备的产业化实力，持续助推新一代光电半导体技术规模化、商业化落地应用。

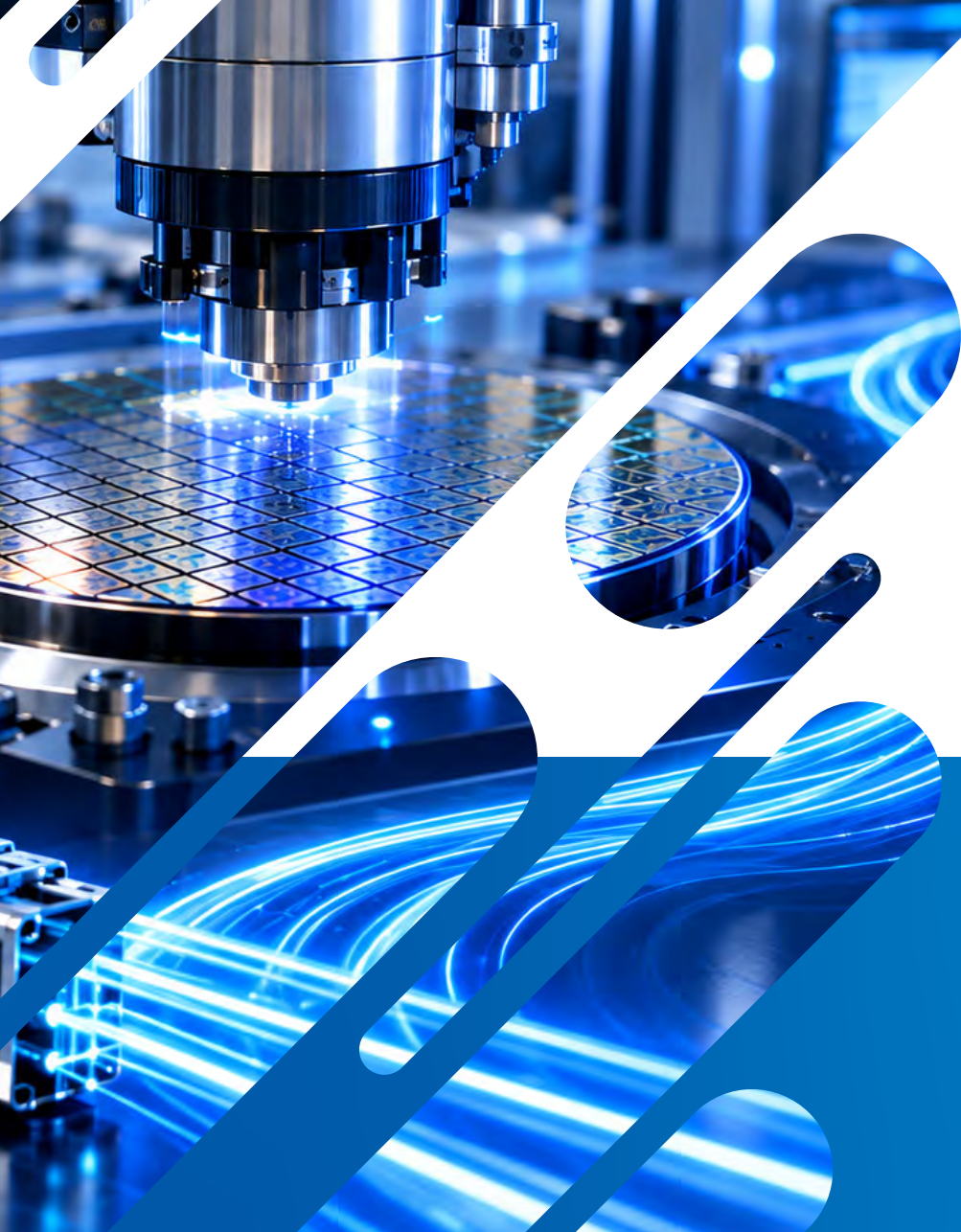
依托分工协同，打通完整智算创新生态

【晶圆制造 | 先进封装 | 半导体设备】：打造算力底层芯片内核，筑牢算力计算底座；

代表企业：GlobalFoundries、Tower Semiconductor、华虹集团、积塔半导体、晶合集成、新芯股份、增芯科技、通富微电、华天科技、盛美上海、拓荆科技、海海清科、微崇半导体等；

【硅光 | CPO | 高速光互联】：搭建算力高速光互连网络，打通算力传输通道；

代表企业：COHERENT高意、海思、光迅、华工正源、新易盛、纳真科技、剑桥、立讯技术、联特、智禾光通、CORNING、长飞、亨通、华三、锐捷网络、烽火、光库等；



链通算力-存储-应用, 筑牢AI算力硬件根基

三展联动贯通算力芯片→高速互联光器件→电子硬件→终端应用完整创新链条, 聚合上下游企业、技术与解决方案, 一站式赋能AI算力技术迭代与产业规模化落地, 以存算一体化为抓手, 补强算力系统底层性能短板。

部分展示企业:

【芯片及芯片设计】:深耕AI芯片底层布局, 健全国产AI算力全链条生态;

代表企业:兆易创新、国民技术、中兴微、北京君正、华强半导体、国芯科技、算能科技、珠海芯动力、达摩院玄铁、思凯迈、象帝先、澜昆微、云联半导体、安信达等;

【存储器件 | 电源与供配电 | 嵌入式硬件】:完善算力配套硬件, 夯实算力硬件支撑底座;

代表企业:长江存储、华大电子, 长江万润、朗科、东芯半导体、宇瞻、科摩思、德明利、澜起科技、研华科技、SEGGER 中国(哲戈微)、安勤科技、上海贝岭、爱浦、信安半导体、芯控源、荣和美等;

*以上仅部分三展同期展示企业, 排名不分先后;

同期部分相关会议:

- AI算力时代硅光产业峰会
- 先进封装与测试技术论坛
- 光电融合技术与产业发展论坛
- AI算力集群光互连技术发展论坛
- 固态变压器(SST)技术创新与产业发展论坛
- AI数据中心光电融合技术创新论坛

三展联动

全链路赋能半导体与智能制造升级

依托三展联动协同优势，整合智能制造全产业链优质资源，一站式汇聚半导体材料、半导体设备、半导体制造及封装服务、光学精密加工、激光器及激光设备、工业嵌入式、核心零部件系统、测试测量等板块展品，完整覆盖芯片制造与封测检测、光学精密加工、视觉检测、激光制造等半导体及智能制造全技术链路，助力产业实现提质增效与柔性智造升级。

三展联动 | 参展价值升级, 精准资源高效链接

依托三展联动优势，汇聚高质量专业观众，覆盖全产业链条，从商机拓展到产业交流，为参展企业提供全方位、多维度赋能。

精准触达核心观众



半导体制造相关企业集中展示新产品、新工艺，直面晶圆厂、封测厂、IDM等优质采购与供应链客户，高效促成精准对接；

&

拓宽商贸合作圈层



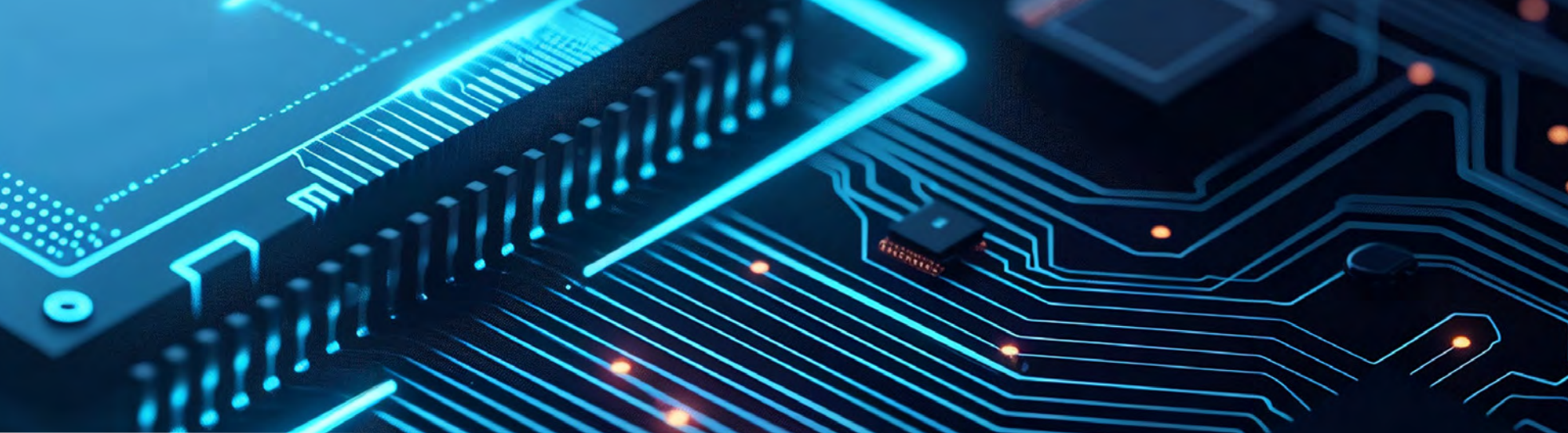
同时汇聚海量自动化设备、精密加工领域展商及观众，帮助参展企业突破固有圈层，挖掘增量商机；

&

打通上下游协同链路



半导体核心零部件企业可面向更广范围的自动化设备厂商、系统集成商对接合作，实现产业链协同共赢；



部分展示企业：

晶圆制造及封装测试服务：GlobalFoundries、Tower Semiconductor、芯联集成、联合微电子、积塔半导体、晶合集成、武汉新芯、增芯科技、通富微电、华天科技、芯植微、佰维存储、时代民芯、锐立平芯、新核芯、安吉海万欣等；

半导体设备：盛美上海、拓荆科技、华海清科、微崇半导体、华煜半导体、精测电子、北京中电科、中科飞测、隆友德、华卓精科、迈为技术、东方晶源、维嘉科技、三丰精密、容道社、冠礼科技、光粒半导体、理纯洁净、海目芯微、津上智造、钧华半导体、致和半导体、维嘉科技、微法尔、四元数、海浣半导体、艾恩、博涛智能、芯慧联芯、佳智彩、运泰利、伊创科技、幕帆科技、昌鼎电子、稳顶聚芯、华封科技、西斯特等；

激光器及激光加工：IPG、锐科、大族、长光华芯、创鑫、Light Conversion、Litolit、富通尼、罗悉激光、华光、中辉、晶众、公大激光、英诺激光、卓立汉光、英谷激光、华工、联赢、海目星、韵腾、镭射沃、玉之泉、艾贝特、紫宸、古洛、创科达、新耐视、正运动、奇光、菲镭泰克、迹点激光、环立等；

智能装备及工业自动化：华工、芯基微、米思米、东佑达、圭华智能、矽万、库尔特埃莎、固安力、精准机械、晨兴智能、凯特精密、誉展精密、立可自动化、魔技纳米、菲格斯、佳迈、锐健、艾瑞森、武藏、进和、藕道智能、繁易、凯福、金源、千里智能、爱合发、研成工业、多场科技、卓创、捷传、万合精密、永翔顺等；

精密光学加工：阿美特克·普瑞思泰克、DKSH、Satisloh、克兰菲尔德精密、广浩捷、优普纳、北京海普超精、博众泰达等；

光学镀膜设备：布勒莱宝、日本光驰、博顿光电、汇成真空、上海哈呐、艾微普、IZOVAC、国泰真空、新柯隆等；

工业传感器：米铤、Stella、ODTech、滨松、锐芯微、派铱兹、光引科技、万赢、睿芯源等；

*以上仅部分三展同期展示企业，排名不分先后；

同期部分相关会议：

- 半导体制造核心设备与零部件发展论坛
- 第十届中国系统级封装大会
- 先进封装与测试技术论坛
- 第二届边缘AI与智能控制技术行业论坛
- 智能工控赋能自动化创新论坛
- IWAPS 国际先进光刻技术研讨会

展馆分布图

2027年9月8-10日 | 深圳国际会展中心(宝安)



HALL
14/16



IICIE

国际集成电路创新博览会
INTERNATIONAL INTEGRATED CIRCUIT INNOVATION EXPO

同期展会

HALL
15

alexcon
深圳国际电子展
暨 嵌入式展

HALL
1-13

CIOE
中国光博会

www.iicieexpo.com



官方微信公众号



官方小程序